

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於僅屬概要，故未包含對閣下而言可能屬重要的全部資料。閣下在決定[編纂]前務請閱讀本文件全文。

任何[編纂]均存在風險。[編纂]的若干特定風險載於「風險因素」。閣下在決定[編纂]前應細閱該節。

概覽

我們是誰

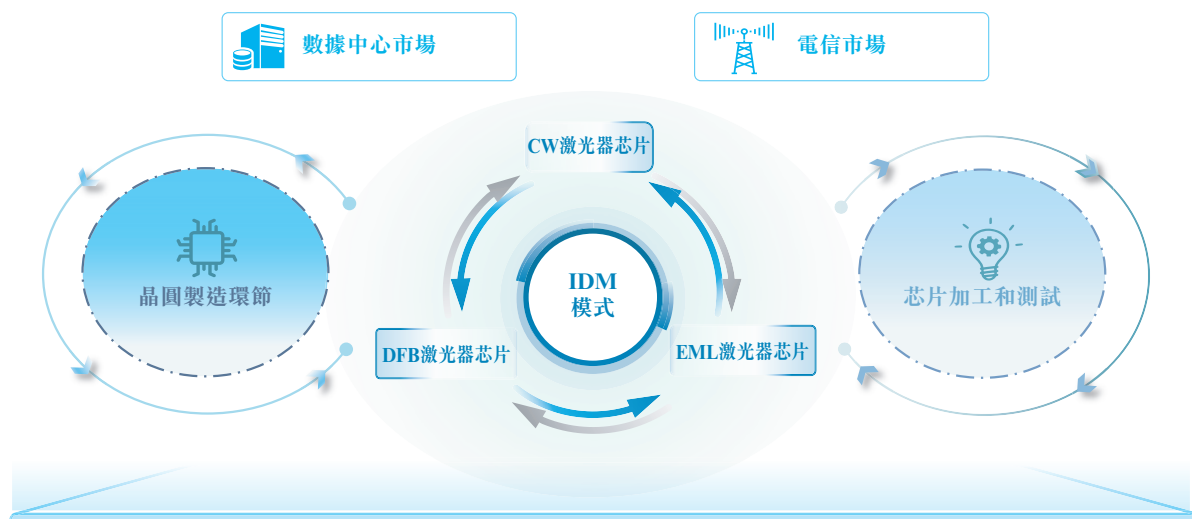
我們是全球領先的激光器芯片供應商，憑藉在光電子半導體設計和製造領域的長期技術和工藝積累，致力於提供高可靠性、高速率、大批量高質交付的激光器芯片，實現數據的極致互連。我們的核心產品組合，包括CW激光器芯片、EML激光器芯片及DFB激光器芯片，覆蓋AI數據中心、5G通信建設及光纖接入等核心場景。根據灼識諮詢的報告，以2025年的對外銷售收入計，我們是全球第六大激光器芯片供應商以及全球第二大硅光高速率光互連產品激光器芯片供應商。我們是全球少數能夠以千萬顆單位規模量產CW激光器芯片的公司之一，這凸顯了我們在全球供應鏈中的獨特地位及可靠性。

AI模型與應用的快速發展，正帶動算力需求的海量增長，進而推升對高速率、低延遲數據傳輸能力的需求。為滿足新一代AI數據中心對於大規模、高速率及高可靠互連的要求，光互連已成為關鍵解決方案，具備更高帶寬潛力、更低傳輸損耗及良好的抗電磁干擾能力等優勢。作為光互連系統的核心，激光器芯片扮演關鍵角色，其將電信號轉換為光信號進行傳輸，直接影響光傳輸的質量、穩定性及帶寬等核心性能指標。這為應用於數據中心領域的EML激光器芯片及CW激光器芯片帶來了強勁且可持續的需求，尤其是高性能激光器芯片，尤為適合支持AI數據中心不斷增長的需求。同樣，電信市場持續存在對中低速率激光器芯片的需求，同時亦對更先進激光器芯片產生需求，以支持高速應用。

我們在激光器芯片的研發和製造領域擁有深厚的專業知識和經驗積累，且前瞻性的策略使我們能夠捕捉這個強勁市場中的機遇。我們採用垂直整合製造商（「IDM」）模式營運，覆蓋研發、晶圓製造、芯片加工、封裝及測試等整個價值鏈。這種全方位的垂直整合確保了穩定的產品質量、可靠的供應以及可擴展的製造產能，同時讓我們能在AI驅動的世界中快速研發新產品並加速產品的迭代。我

概 要

們目前提供涵蓋多種類型的全面激光器芯片產品組合，以服務兩大關鍵應用領域：數據中心及電信。通過對生產過程的嚴格管控，我們得以滿足客戶的嚴格要求，並保持在光互連價值鏈的前沿地位。下圖展示了我們的簡化業務模式、主要產品及其關鍵應用領域：



隨著時間推移，我們已將自身能力轉化為一系列顯著成就，包括產品研發突破、成功取得客戶認證、大規模擴充製造產能，以及實現高效商業化。下圖呈現了我們主要的成就：



附註：

(1) 根據灼識諮詢，以2025年的對外銷售收入計量。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

- (2) 根據灼識諮詢，按2025年全球光模塊銷售量計。
- (3) 根據灼識諮詢。
- (4) 根據灼識諮詢，按2025年銷量計。
- (5) 自2023年至2025年。

我們的產品

我們提供全面的激光器芯片產品組合，旨在滿足多種數據傳輸速率、性能要求及應用需求，彰顯我們在行業內的廣泛覆蓋。我們的產品組合分為兩大關鍵產品線：

- **數據中心激光器芯片。**我們提供支持400G/800G及以上光模塊以及下一代光互連解決方案的DFB激光器芯片、EML激光器芯片及CW激光器芯片，實現高帶寬、高速率、低延遲的數據傳輸，滿足快速增長的數據中心需求。
- **電信激光器芯片。**我們專門為光纖接入及4G/5G前傳與中傳部署提供全面的FP激光器芯片、DFB激光器芯片及EML激光器芯片產品組合，滿足高速通信網絡不斷演進的需求。

我們是全球少數幾家CW激光器芯片、EML激光器芯片及DFB激光器芯片均已通過行業領先企業嚴格認證並實現大規模商業化的公司之一。這種廣泛的產品組合彰顯了我們前沿激光器芯片解決方案服務多元性市場分部的能力。

在當今的數據中心市場，光互連解決方案主要通過光模塊實現。這些光模塊遵循兩種主要技術路徑：一種是早期開發的EML設計，依靠高性能EML激光器芯片實現先進的數據傳輸速率(如用於400G和800G光模塊的EML激光器芯片)，二是集成度更高的硅光架構，該架構需要CW激光器芯片作為外部激光源，支持其高集成度。兩種路徑對激光器芯片提出了不同的技術要求，使得具備更全面技術的企業對於滿足不斷演變的市場需求至關重要。我們憑借全面的產品組合，在兩條技術路線上均具備把握增長機遇的獨特優勢。我們能夠提供適用於EML激光器芯片及硅光架構的高性能、高可靠性激光器芯片，從而滿足AI驅動的數據中心時代下多元化的市場需求，並進一步鞏固我們在快速演進的光互連行業中的領先地位。此外，在電信市場，DFB激光器芯片及EML激光器芯片的應用更為廣泛。

我們因應不斷變化的市場需求持續擴展及升級產品組合，短期聚焦CW激光器芯片產量進一步躍升及100G/200G EML激光器芯片的商業化突破；中長期繼續推動高端CW激光器芯片的突破和商業化落地，以及推動更高速率EML激光器芯片的演進，進而鞏固我們的市場領導地位，並支持下一代光互連解決方案的應用。

我們的增長機遇

AI的快速發展及不斷演變的連接需求正為高性能激光器芯片創造大量增長機遇。AI技術正推動對算力、存儲及高速連接的需求，促使全球主要雲端服務供應商擴大基礎設施投資，以支持下一代AI工作負載。隨著大規模AI運算集群與高性能運算硬件持續擴張，互連性能已成為關鍵瓶頸，進而

概 要

推升對更高帶寬、更高數據速率能力及低延遲光互連的需求。根據灼識諮詢，全球數據中心光互連市場預計將從2024年的137億美元增長至2030年的1,444億美元，年複合增長率達48.1%。

與此同時，憑藉高集成度、能源效率及成本優勢，硅光作為一種創新的光模塊設計技術正日益受到重視。硅光支持從可插拔設計到新興集成技術（如近封裝光學技術（「**NPO**」）及共封裝光學技術（「**CPO**」）的廣泛互連解決方案，預計將成為數據中心光互連領域增長最快的細分市場之一。該趨勢進一步凸顯了CW激光器芯片作為推動下一代光互連的不可或缺之技術的戰略重要性。除數據中心市場外，電信市場對更高帶寬與更強處理能力的需求，亦推動25G/50G PON技術的應用。

依託前瞻性的研發、全球整合能力及穩健的產能，我們具備戰略優勢來把握該等機遇。憑借在早期洞察硅光的潛力，並透過持續創新，我們目前已在CW激光器芯片領域實現領先。並且，憑藉著我們在CW激光器芯片及高速EML激光器芯片的全面產品佈局，我們能夠把握由AI計算和應用的爆發增長所驅動的日益增長的市場需求。立足全球化營運佈局及融入領先科技公司的供應鏈，我們為全球客戶提供支持，確保高品質產品的穩定供應。

我們的成果

我們於2013年在中國陝西省成立，一直秉持前瞻性的產業發展眼光及務實理念，強調工藝優化、沉澱及穩定，專注於滿足客戶對激光器芯片穩定量產及高品質的核心要求。2022年，我們完成首次公開發售並於上交所科創板上市，使我們能夠以更快的速度及更大的規模執行戰略。

於往績記錄期間，我們積極把握全球AI驅動運算升級的趨勢，將產品組合由2.5G、10G及25G DFB激光器芯片及EML激光器芯片，擴展至25G、50G及100G EML激光器芯片以及50mW、70mW及100mW CW激光器芯片等高端產品。2025年，受AI運算需求激增帶動，我們的數據中心激光器芯片產品收入超過電信激光器芯片產品，成為主要增長動力。因此，我們的收入由2023年人民幣144.4百萬元增加至2025年人民幣601.4百萬元，年複合增長率為104.1%。同時，毛利由2023年人民幣41.5百萬元增加至2025年人民幣334.8百萬元，年複合增長率為184.0%。

技術及研發

經過多年的研發投入與產業化驗證，我們已構建起涵蓋激光器芯片外延生長、晶圓製造、芯片設計、單片集成到高頻封裝測試的完整激光器芯片技術體系。我們將核心專有技術整合為六大技術平台，以滿足數據中心、電信網絡及新一代光互連應用中對高速度、大功率、成本優化及高可靠性日

概 要

益增長的需求。該六大技術平台包括：(i)先進外延與晶圓製造平台技術；(ii)高速光電調製與單片集成平台技術；(iii)大功率光放大集成技術；(iv)芯片級光路優化與系統適配技術；(v)適配多場景可靠性工程技術；及(vi)高頻微組裝與封裝測試技術。

作為一家專注於激光器芯片領域的高科技企業，我們自成立以來始終致力於研發，通過持續投資積累了一系列核心技術。為增強我們的能力，我們不斷加碼研發投入，升級實驗室(包括材料科學設施)，同時購置先進的生產和測試設備來提升研究環境。我們的戰略以市場為導向，且我們積極調整產品迭代和技術預研，以適應行業趨勢，確保解決方案保持競爭力。此外，我們建立了一個多層次研發架構，並輔以強大的激勵機制，以獎勵對產品創新、參數改進和專利申請的貢獻。我們培養一支技術精湛的工程人才隊伍，並積極招募高素質的專家，不斷提升我們的自主創新能力和技術水平。

我們的研發活動受行業發展、應用需求和研發項目驅動。新產品開發流程按照研發部的《設計和開發控制程序》管理。我們的研發流程通常依次經歷六個階段，包括項目啟動、項目設計與開發、工程驗證測試、設計驗證測試、研發轉產及生產驗證測試。只有當前階段的要求得到滿足後，項目才能進入下一階段。

製造

我們採用IDM模式運營，已掌握激光器芯片製造的核心技術，內部能力覆蓋芯片設計、晶圓製造、芯片加工及測試。這種IDM模式使我們能夠縮短產品開發週期，實現獨立可控的激光器芯片製造，快速響應客戶需求並有效提供相應的解決方案，從而使我們能夠快速響應不斷變化的市場需求。截至最後實際可行日期，我們有兩個投入運營的生產基地，均位於陝西省，總建築面積超28,000平方米。另外，我們在陝西省的其中一個生產基地目前正進行產能擴建，以容納額外生產設施，滿足日益增長的需求。

我們的生產活動受到市場需求驅動。生產運營部根據客戶訂單，協調相關部門制定生產計劃。按照我們的年度銷售策略，我們會進行產能評估，並保持合理的存貨水平，以應對需求高峰，緩解生產壓力。此外，我們擁有一支高素質的製造團隊。截至2025年12月31日，我們共有535名僱員從事製造工作。

我們還將在未來重點加強可靠性工程及出貨前測試方面的能力。我們計劃持續優化加速壽命老化測試、壽命評估及故障分析，確保產品在客戶應用中的長期穩定性。同時，我們亦會增加和升級測試設施，提升出廠檢驗中對芯片性能、可靠性及外觀品質的評估能力。此外，我們正擴大及提升材料測試實驗室的規模與能力，以進行更全面的成分與性能測試，確保從原材料到成品各環節均達到最高品質標準。

概 要

銷售及營銷

由於激光器芯片是光模塊中的核心器件，客戶通常需要供應商在產品性能、驗證導入及技術協同方面提供更直接和深入的支持，因此我們主要採用直銷模式。該方法使我們能夠維持及深化與主要客戶的戰略關係，確保密切合作及更好地了解彼等不斷變化的需求。同時，我們也通過分銷渠道進行銷售，尤其是我們電信激光器芯片的銷售，以高效方式擴大客戶覆蓋範圍。我們擁有一支專業的銷售及營銷團隊，負責客戶發掘、產品推廣及客戶關係管理。該經驗豐富、訓練有素的銷售及營銷團隊積極尋覓市場機會，制定銷售策略。

供應商及客戶

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括原材料、設備及封裝服務的供應商。我們已在中國、歐洲及日本建立廣泛的供應商網絡。在利用進口原材料生產高質量芯片的同時，我們亦積極與國內供應商建立合作關係，不斷尋求多元化的供應鏈。於2023年、2024年及2025年，我們每年合共向五大供應商採購的金額分別為人民幣32.4百萬元、人民幣54.9百萬元及人民幣83.1百萬元，分別佔相應年度我們總採購額的51.9%、56.9%及48.1%。於2023年、2024年及2025年，我們向各年度最大供應商的採購額分別為人民幣10.7百萬元、人民幣18.0百萬元及人民幣20.7百萬元，分別佔相應年度我們總採購額的17.2%、18.7%及12.0%。

此外，我們的客戶主要為光器件及光模塊製造商以及我們的分銷商。於2023年、2024年及2025年，我們每年向前五大客戶銷售產生的收入總額分別為人民幣80.2百萬元、人民幣148.9百萬元及人民幣431.9百萬元，分別佔相應年度總收入的55.6%、59.1%及71.8%。於2023年、2024年及2025年，我們向各年度最大客戶銷售產生的收入分別為人民幣27.5百萬元、人民幣41.3百萬元及人民幣320.8百萬元，分別佔相應年度我們總收入的19.0%、16.4%及53.4%。

在往績記錄期間，我們的部分主要供應商亦同時為我們的客戶，反之亦然，因而在某些情況下客戶與供應商關係存在重疊。詳情請參閱「業務 — 客戶 — 客戶與供應商重疊」。

競爭優勢

我們認為，以下競爭優勢促成了我們的成功，並使我們區別於競爭對手：

- 憑藉廣泛且先進的高速光互連產品組合，躋身領先激光器芯片提供商；
- 基於先進設計能力、製造工藝及嚴格質量控制的綜合技術實力；
- IDM模式帶來卓越的交付能力、端到端自主可控能力與可擴展的製造實力；
- 藍籌客戶基礎與深度戰略合作，提供獨特市場洞察；及
- 遠見卓識且兼具全球視野的研發及製造團隊。

概 要

增長戰略

我們計劃實施以下戰略，以實現我們的願景及使命：

- 持續開展研發投資，推進產品與製程創新；
- 打造協同高效的全球運營網絡，推動產能戰略化落地；
- 加速融入AI產業生態，深化客戶關係；
- 堅定聚才賦能，打造一流人才生態平台；及
- 通過戰略併購方式擴充產品矩陣，充分釋放客戶優勢潛能。

競爭

我們所處的行業競爭激烈。激光器芯片市場既面臨來自國際知名企業的激烈競爭，也面臨著來自國內新興製造商的挑戰。在中國及全球範圍內，我們的產品在激光器芯片行業均面臨直接競爭。隨著國內新進入者目前正尋求進入市場，預計競爭將進一步加劇。隨著某些光模塊製造商日益增強內部芯片研發能力，以構建一個涵蓋光模塊、激光器芯片和光網絡終端的協作式全產業鏈體系，預計競爭將愈發激烈。

此外，技術革新正在重塑競爭格局。行業正朝著具有更高數據速率、更高輸出功率和更長傳輸距離的激光器芯片發展。研發能力更強、產品迭代週期更快的公司正獲得競爭優勢。詳情請參閱「行業概覽」。

歷史及財務資料概要

下表列示的合併財務數據概要源自本文件附錄一會計師報告所載我們於往績記錄期間的合併損益表及合併現金流量表，以及截至2023年、2024年及2025年12月31日的合併財務狀況表。以下數據及討論應與我們的合併財務報表及相關附註以及「財務資料」章節一併閱讀。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

合併損益表概要

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
收入	144,404	100.0	252,173	100.0	601,435	100.0
銷售成本	(102,906)	(71.3)	(193,270)	(76.6)	(266,613)	(44.3)
毛利	41,498	28.7	58,903	23.4	334,822	55.7
其他收入	14,054	9.7	2,182	0.9	12,041	2.0
其他收益或虧損淨額	9,104	6.3	3,593	1.4	(3,719)	(0.6)
銷售及營銷開支	(8,355)	(5.8)	(18,532)	(7.3)	(23,784)	(4.0)
一般及行政開支	(25,937)	(18.0)	(26,053)	(10.3)	(45,135)	(7.5)
研發開支	(30,946)	(21.4)	(54,518)	(21.6)	(80,843)	(13.4)
金融資產減值損失(扣除撥回)	(2,856)	(2.0)	2,829	1.1	(6,524)	(1.1)
財務收入淨額	21,590	15.0	17,973	7.1	12,883	2.1
應佔聯營公司業績	2	0.1	(1,689)	(0.7)	14,031	2.3
稅前利潤／(虧損)	18,154	12.6	(15,312)	(6.0)	213,772	35.5
所得稅(開支)／抵免	1,326	0.9	9,179	3.6	(22,848)	(3.8)
年內利潤／(虧損)	19,480	13.5	(6,133)	(2.4)	190,924	31.7

非《國際財務報告準則》計量

為補充我們根據《國際財務報告準則》呈列的綜合財務報表，我們亦使用經調整淨利潤／(虧損)(非《國際財務報告準則》計量)作為額外的財務計量(該等計量並非《國際財務報告準則》所要求或根據《國際財務報告準則》呈列)。我們將經調整淨利潤／(虧損)(非《國際財務報告準則》計量)定義為年內利潤／(虧損)，並就股份支付開支作出調整，該等費用屬非現金性質，源於向僱員授出股份獎勵。

我們認為，這一非《國際財務報告準則》計量有助於消除若干項目的潛在影響，從而促進年度間及公司間的經營業績比較，並為投資者及其他人士提供有益信息，助其以與管理層相同的方式理解和評估我們的經營業績。然而，我們呈列的經調整淨利潤／(虧損)(非《國際財務報告準則》計量)可能與其他公司呈列的名稱類似的計量不具可比性。此類非《國際財務報告準則》計量作為分析工具存在侷限性，閣下不應將其孤立看待，也不應將其作為根據《國際財務報告準則》列報的經營業績或財務狀況分析的替代。

下表載列經調整淨利潤／(虧損)(非《國際財務報告準則》計量)與根據《國際財務報告準則》編製的最近似計量指標(即年度利潤／(虧損))之間的調節情況：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年內利潤／(虧損)	19,480	(6,133)	190,924
加：			
股份支付開支	3,549	3,662	32,162
經調整淨利潤／(虧損)(非《國際財務報告準則》計量)	23,029	(2,471)	223,086

概 要

收入

於往績記錄期間，我們的收入主要來自銷售數據中心激光器芯片及電信激光器芯片。我們亦通過提供技術服務及其他服務（主要涉及特定類型激光器芯片的定製開發及合同製造服務）產生少量收入。產品銷售收入於交付並經客戶驗收時確認，而技術服務收入則根據服務交付及驗收進度按時間段確認。下表載列我們於所示年度按產品線劃分的收入明細，以絕對金額及佔我們總收入的百分比列示：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
數據中心激光器芯片	4,614	3.2	48,013	19.0	393,258	65.4
電信激光器芯片	133,054	92.1	202,304	80.2	206,470	34.3
技術服務及其他 ⁽¹⁾	6,736	4.7	1,856	0.8	1,707	0.3
合計	144,404	100.0	252,173	100.0	601,435	100.0

附註：

(1) 技術服務及其他主要包括特定類型激光器芯片的定制開發及合同製造服務。

於2023年及2024年，我們的大部分收入來自銷售電信激光器芯片，小部分來自銷售數據中心激光器芯片。儘管如此，我們銷售數據中心激光器芯片的收入於往績記錄期間快速增長。2025年，來自銷售數據中心激光器芯片的收入超過銷售電信激光器芯片收入，佔年度總收入的65.4%。這一轉變主要是由人工智能計算中心加速部署、高速光互連及硅光應用日益普及所導致的我們數據中心激光器芯片銷量的擴張，以及我們在這些市場的銷售規模擴大及客戶關係深化所推動。為順應這些行業趨勢，我們正在繼續增強我們的數據中心激光器芯片供應，並增加我們在該產品線的市場份額。此外，我們的技術服務及其他收入由2023年的人民幣6.7百萬元減至2024年的人民幣1.9百萬元，並進一步減至2025年的人民幣1.7百萬元。該減少主要是由於我們的技術服務及其他服務主要由定製開發項目組成，該等項目通常是項目制。

概 要

激光器芯片銷售收入主要受銷量及平均售價驅動。下表載列於所示年度按產品線劃分的激光器芯片銷量及平均售價明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾
	每件人民幣		每件人民幣		每件人民幣	
	千件	幣元	千件	幣元	千件	幣元
數據中心激光器芯片	225	20.5	2,285	21.0	17,721	22.2
電信激光器芯片	28,029	4.7	49,915	4.1	35,711	5.8

附註：

(1) 平均售價乃按該產品線某一年度的收入除以銷量計算。

我們數據中心激光器芯片的銷量由2023年的0.2百萬顆大幅增至2024年的2.3百萬顆，並進一步增至2025年的17.7百萬顆，平均售價於2023、2024及2025年分別約為每顆人民幣20.5元、21.0元及22.2元，保持相對穩定。我們電信激光器芯片的銷量則經歷波動，於2023、2024及2025年分別為28.0百萬顆、49.9百萬顆及35.7百萬顆，平均售價分別為每顆人民幣4.7元、4.1元及5.8元。

自2023至2024年，我們激光器芯片整體銷量的增長主要受電信市場需求恢復所驅動。2024年到2025年，我們激光器芯片的整體銷量保持穩定。兩條產品線銷量的差異主要由於我們積極優化產品組合，並重新分配資源，優先支持高價值產品，包括數據中心激光器芯片及高端電信激光器芯片。

於往績記錄期間，我們推廣激光器芯片的方式主要以直銷為主、分銷渠道為輔。我們通過分銷模式產生的銷售收入由2023年的人民幣26.6百萬元大幅增加至2024年的人民幣74.8百萬元，主要由於電信市場需求的恢復，而分銷模式主要運用於電信市場激光器芯片的銷售中。我們通過分銷渠道產生的收入由2024年的人民幣74.8百萬元減少14.4%至2025年的人民幣64.0百萬元，主要由於我們的CW激光器芯片成功拓展市場，且該等CW激光器芯片乃主要通過直銷出售予客戶。下表載列截至所示年度我們按銷售渠道劃分的收入明細，按絕對金額及佔總收入的百分比呈列：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
直銷	117,756	81.5	177,334	70.3	537,405	89.4
分銷	26,648	18.5	74,839	29.7	64,030	10.6
合計	144,404	100.0	252,173	100.0	601,435	100.0

概 要

銷售成本

我們的銷售成本主要包括(i)製造成本，主要包括我們激光器芯片的封裝費及生產相關的物業、廠房及設備以及使用權資產的折舊；(ii)人工成本，主要與參與生產的僱員有關；(iii)原材料成本；(iv)稅費及附加費；及(v)存貨減值。下表載列我們於所示年度按性質劃分的銷售成本明細，以絕對金額及佔銷售成本總額的百分比列示：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
製造成本	57,774	56.1	120,507	62.4	139,880	52.5
人工成本	16,588	16.1	36,838	19.1	70,953	26.6
原材料成本	10,067	9.8	22,562	11.7	51,767	19.4
稅費及附加費	2,826	2.7	2,836	1.5	4,687	1.8
存貨減值	15,651	15.3	10,527	5.3	(674)	(0.3)
合計	<u>102,906</u>	<u>100.0</u>	<u>193,270</u>	<u>100.0</u>	<u>266,613</u>	<u>100.0</u>

毛利及毛利率

我們的毛利指收入減銷售成本，而毛利率指毛利佔收入的百分比。下表載列我們於所示年度按產品線劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
數據中心激光器芯片	1,165	25.2	29,796	62.1	280,228	71.3
電信激光器芯片	35,556	26.7	29,020	14.3	53,470	25.9
技術服務及其他	4,777	70.9	87	4.7	1,124	65.8
合計	<u>41,498</u>	<u>28.7</u>	<u>58,903</u>	<u>23.4</u>	<u>334,822</u>	<u>55.7</u>

我們產生自數據中心激光器芯片的毛利由人民幣1.2百萬元大幅增至2024年的人民幣29.8百萬元，並進一步增至2025年的人民幣280.2百萬元，主要受數據中心基礎設施擴張及高速光互連解決方案日益普及所導致的數據中心激光器芯片銷量持續增長所推動。數據中心激光器芯片的毛利率由2023年的25.2%增至2024年的62.1%，並進一步增至2025年的71.3%，主要反映我們持續優化該產品線產品組合，逐步推出並開始大規模出貨更高性能的EML激光器芯片及CW激光器芯片。

我們電信激光器芯片的毛利由2023年的人民幣35.6百萬元降至2024年的人民幣29.0百萬元，主要因市場環境下的價格壓力，儘管銷量有所增加。我們產生自電信激光器芯片的毛利由2024年的人民幣29.0百萬元增至2025年的人民幣53.5百萬元，主要由於我們高端電信激光器芯片銷量增加。由於

概 要

上文所討論的相同原因，電信激光器芯片的毛利率由2023年的26.7%降至2024年的14.3%，隨後增至2025年的25.9%。

於往績記錄期間，技術服務及其他業務的毛利及毛利率有所波動，主要由於我們技術服務及其他服務的時間安排、規模、複雜性、資源需求及定價均因項目而異。於2023、2024及2025年，我們產生自技術服務及其他業務線的毛利分別為人民幣4.8百萬元、人民幣87千元及人民幣1.1百萬元，毛利率分別為70.9%、4.7%及65.8%。

年內利潤／（虧損）

我們於2023年錄得淨利潤人民幣19.5百萬元，2024年錄得淨虧損人民幣6.1百萬元，2025年則錄得淨利潤人民幣190.9百萬元。於2024年，我們錄得淨虧損人民幣6.1百萬元，主要由於(i)我們電信激光器芯片分部的整體毛利率下降，原因是該分部若干產品因市場競爭加劇而面臨的定價下行壓力；及(ii)為支持我們的持續研發活動及市場擴張，我們的研發開支與銷售及營銷開支有所增加。於2025年，我們的淨利潤為人民幣190.9百萬元，主要由於我們的收入及毛利大幅增加，原因是我們積極優化產品組合併增加數據中心激光器芯片及高端電信激光器芯片銷量，而該等產品的平均售價普遍較高。

合併財務狀況表概要

下表載列截至所示日期我們合併財務狀況表的選定資料：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總值	605,837	736,328	1,315,311
流動資產總值	1,630,846	1,411,218	1,269,939
資產總值	2,236,683	2,147,546	2,585,250
流動負債總值	95,269	53,949	178,703
非流動負債總值	24,726	20,830	74,262
負債總值	119,995	74,779	252,965
流動資產淨值	1,535,577	1,357,269	1,091,236
資產淨值	2,116,688	2,072,767	2,332,285
權益總額	2,116,688	2,072,767	2,332,285

概 要

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣1,535.6百萬元減少至截至2024年12月31日的人民幣1,357.3百萬元，主要由於(i)現金及現金等價物減少人民幣262.4百萬元，主要反映為應對日益增長的市場需求，支持業務擴張所產生的現金流出，包括用於擴大產能和股權投資的資本支出；及(ii)存貨減少人民幣18.1百萬元，主要由於市場復甦帶動銷量提升及存貨撇減增加，部分被其他應付款項及應計項目減少人民幣37.9百萬元所抵銷，該減少主要歸因於公司大樓建設的最終結算的時間差異。

我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣1,357.3百萬元進一步減少至截至2025年12月31日的人民幣1,091.2百萬元，主要由於(i)現金及現金等價物減少人民幣285.2百萬元，主要反映為應對日益增長的市場需求，支持業務擴張所產生的現金流出，包括用於擴大產能的資本支出；及(ii)其他應付款項及應計費用增加人民幣69.8百萬元，主要由於設備採購增加，部分被貿易應收款項增加人民幣143.5百萬元所抵銷，該增加主要歸因於我們的業務增長。

我們截至2023年12月31日錄得權益總額人民幣2,116.7百萬元。我們的權益總額減至截至2024年12月31日的人民幣2,072.8百萬元，主要由於(i)股份回購人民幣55.4百萬元；(ii)股息人民幣8.5百萬元，及(iii)年內虧損人民幣6.1百萬元，部分被因行使股份期權而發行新股增加人民幣22.5百萬元所抵銷。截至2025年12月31日，我們的權益總額增至人民幣2,332.3百萬元，主要歸因於(i)年內利潤人民幣190.9百萬元，(ii)股份支付稅務影響人民幣58.4百萬元，及(iii)來自股份支付開支的資本儲備增加人民幣32.2百萬元，部分被股息人民幣42.7百萬元及其他全面開支人民幣10.3百萬元所抵銷。

綜合現金流量表摘要

下表載列於所示年度我們的現金流量概要：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
經營活動(所用)／所得現金淨額	(17,399)	18,960	150,236
投資活動所用現金淨額	(37,777)	(231,663)	(403,923)
融資活動所用現金淨額	(27,020)	(42,600)	(16,767)
現金及現金等價物減少淨額	(82,196)	(255,303)	(270,454)
匯率變動的影響	(70)	128	(11,125)
年初現金及現金等價物	1,414,916	1,332,650	1,077,475
年末現金及現金等價物	1,332,650	1,077,475	795,896

概 要

於往績記錄期間，我們現金的主要用途是為營運、資本開支及一般營運資金需求提供資金。過往，我們主要通過股權融資及業務經營所得現金為運營及其他資本需求提供資金。我們預計現金需求主要包括與研發活動、製造活動、擴大產能和日常運營有關的成本。我們預計通過經營所得現金、[編纂]以及(如必要)銀行及其他借款為我們未來的營運資金及其他現金需求提供資金。

於2023年，我們錄得經營活動所用現金淨額人民幣17.4百萬元。於2024年及2025年，我們錄得經營活動所得現金淨額人民幣19.0百萬元及人民幣150.2百萬元。於2023年、2024年及2025年，我們錄得投資活動所用現金淨額人民幣37.8百萬元、人民幣231.7百萬元及人民幣403.9百萬元，以及錄得融資活動所用現金淨額人民幣27.0百萬元、人民幣42.6百萬元及人民幣16.8百萬元。

主要財務比率

下表載列我們截至所示期間及於所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日／截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
毛利率	28.7%	23.4%	55.7%
收入增長率 ⁽¹⁾	不適用	74.6%	138.5%
流動比率 ⁽²⁾	17.1	26.2	7.1
速動比率 ⁽³⁾	15.6	23.9	6.4
資產負債率 ⁽⁴⁾	5.4%	3.5%	9.8%
淨利潤／(虧損)率	13.5%	(2.4%)	31.7%
經調整淨利潤／(虧損)率(非《國際財務報告準則》計量) ⁽⁵⁾	15.9%	(1.0%)	37.1%

附註：

- (1) 收入增長率按收入的同比增長率計算。
- (2) 流動比率等於截至相關年度末的流動資產除以流動負債。
- (3) 速動比率等於截至相關年度末的流動資產(不包括存貨)除以流動負債。
- (4) 資產負債率由負債總值除以資產總值計算得出。
- (5) 經調整淨利潤／(虧損)率(非《國際財務報告準則》計量)指該年度的經調整淨利潤／(虧損)(非《國際財務報告準則》計量)除以相同年度的收入，再乘以100%。

詳情請參閱「— 財務資料 — 主要財務比率」。

風險因素

我們的業務及[編纂]涉及本文件「風險因素」章節所載的若干風險。閣下在決定[編纂]我們的H股前，應仔細閱讀該章節全文。我們認為，我們所面臨的最主要的風險包括但不限於以下各項：

- 我們的歷史業績未必能反映我們未來的表現，且我們可能無法成功擴張我們的業務或管理我們的增長。

概 要

- 我們經營所在的行業競爭激烈。倘我們未能成功競爭，我們的業務、經營業績及增長前景可能受損。
- 倘我們未能緊跟半導體行業的技術進步及不斷演變的行業標準，我們的市場地位可能會被削弱，且我們的業務、經營業績及前景可能會受到不利影響。
- 我們的表現受採用我們產品的下游行業需求的影響。該等下游行業的增長放緩可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
- 我們的IDM業務模式需要大量資本開支及產生高昂的固定成本，產能利用率的任何下降或產能擴張與市場需求之間的錯配均可能對我們的盈利能力造成重大不利影響。
- 我們生產廠房營運的任何中斷、未能成功執行產能擴張計劃或未能按期大規模製造或交付高質量產品均可能限制我們的業務營運。
- 我們可能無法完全維持對我們產品的質量控制，且我們產品中未被發現的缺陷、故障或可靠性問題可能降低我們產品的市場採用率、損害我們的聲譽或使我們面臨產品責任、保修及其他申索。

詳情請參閱「風險因素」。

[編纂]

我們估計，假設[編纂]未獲行使，根據每股[編纂]港元（即本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數）的[編纂]計算，扣除[編纂]、費用及我們應就[編纂]支付的估計開支後，我們將從[編纂]中獲得約[編纂]港元的[編纂]。我們擬將[編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]%的[編纂]（即約[編纂]港元）將用於增強研發及測試能力，並擴大激光器芯片的生產產能；
- 約[編纂]%的[編纂]（即約[編纂]港元）將用於戰略投資及業務協同計劃，以充分釋放客戶群體的增長潛力；
- 約[編纂]%的[編纂]（即約[編纂]港元）將用於拓展銷售及服務網絡，並支持市場推廣活動；及
- 約[編纂]%的[編纂]（即約[編纂]港元）將用於我們的營運資金及其他一般公司用途。

概 要

[編纂]

股息

於往績記錄期間，我們分別於2023年、2024年及2025年派付股息人民幣39.4百萬元、人民幣8.5百萬元及人民幣42.7百萬元。

根據我們的組織章程細則及《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號 — 上市公司現金分紅(2025年修訂)》，我們已採納一般年度股息政策，據此我們可宣派現金股息、股票股息或現金與股票股息組合形式的股息。我們優先考慮現金股息。在滿足特定條件的情況下，我們在作出規定的法定儲備金撥備後，應派發過去三年現金股息金額不低於同期實現的平均年度可供分派利潤的30%。前述特定條件包括：(i)我們於相關年度實現了正的可供分派利潤；(ii)截至該年度我們累計可供分派利潤仍為正；(iii)我們的審計師能就相關年度財務報表出具無保留意見；(iv)我們具備充足資本資源、盈利能力及現金流以支持持續及長期經營；(v)我們預計未來十二個月內無重大投資計劃或資本開支(不包括募集資金的投資)；及(vi)不存在其他導致股東大會通過不派發現金股息決議的重大

概 要

情形。但任何建議宣派股息須經董事會酌情決定並須經股東會議批准。董事會可在考慮我們的經營業績、財務狀況、經營要求、資本要求、股東權益和董事會認為可能相關的任何其他條件後，建議未來分派股息。

[編纂]

[編纂]指就[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用。我們估計[編纂]約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，佔[編纂]估計[編纂]約[編纂]%(假設未因行使[編纂]而發行任何股份)。**[編纂]**包括：**(i)**[編纂]相關開支(含[編纂])約[編纂]港元；及**(ii)**非[編纂]相關開支約[編纂]港元，其中包括：**(a)**法律顧問及申報會計師費用及開支約[編纂]港元；及**(b)**其他費用及開支約[編纂]港元。預計[編纂]中約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)直接歸因於[編纂]，並將於[編纂]完成後入賬列為自權益扣減。預計約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將於[編纂]完成前或完成後自損益中扣除。我們認為上述費用或開支對本集團而言均不重大且金額並無異常偏高。上述[編纂]為最新的實際可行估計(僅供參考)，實際金額可能與此估計有所不同。

單一最大股東集團

截至最後實際可行日期，**(i)** Zhang博士直接持有10,575,438股A股，並通過擔任我們的激勵平台欣芯聚源普通合夥人，控制其所持有的1,260,000股A類股份所附帶的表決權；**(ii)**非執行董事秦衛星先生直接持有4,478,859股A股；**(iii)**秦衛星先生的哥哥秦燕生先生直接持有4,604,859股A股；及**(iv)** Zhang博士的妹妹、非執行董事張女士直接持有2,944,053股A股。根據一致行動人士協議，張女士、秦衛星先生及秦燕生先生已同意在股東大會中將其表決權與Zhang博士保持一致。因此，Zhang博士與張女士、秦衛星先生、秦燕生先生及欣芯聚源共同構成本公司單一最大股東集團，有權行使或控制行使本公司截至最後實際可行日期已發行股份總數約27.85%所附帶的表決權(不包括本公司截至最後實際可行日期作為庫存股持有的275,169股A股)。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]本公司股本未發生變動，Zhang博士、張女士、秦衛星先生、秦燕生先生及欣芯聚源將合共控制本公司約[編纂]%的表決權(不包括本公司截至最後實際可行日期作為庫存股持有的275,169股A股)。因此，Zhang博士、張女士、秦衛星先生、秦燕生先生及欣芯聚源將於[編纂]後繼續成為我們的單一最大股東集團。

激勵計劃

截至最後實際可行日期，我們已採用激勵計劃，根據此計劃，884,030股限制性股份已授予合計326名承授人(包括三名董事及三名高級管理層成員)且尚未完成歸屬，且126,900股限制股份仍預留待進一步授予，該等授予將在[編纂]前完成或失效。倘**(i)**預留授予於[編纂]前完成，且其項下的限制

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

性股份已完全歸屬並通過發行A股予以滿足；(ii)激勵計劃項下所有已授予但尚未歸屬的未歸屬限制性股份完全歸屬並通過發行A股予以滿足，則[編纂]後本公司股本將被稀釋約[編纂]%。對我們每股收益的稀釋影響將約為[編纂]%(假設(i)[編纂]未獲行使及(ii)本公司股本於最後實際可行日期至[編纂]之間並無任何變動)。

本公司在上海證券交易所科創板上市及在香港聯交所[編纂]的原因

自2022年12月起，本公司A股已在上海證券交易所科創板上市。我們的董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在任何重大方面均未嚴重違反上海證券交易所科創板股票上市規則及中國其他適用的證券法律法規，且經董事作出一切合理查詢後所知，概無有關我們於上海證券交易所科創板的合規記錄的重大事宜應提請投資者垂注。

我們根據《上市規則》第8.05(3)條申請[編纂]且符合市值／收益測試要求。本公司尋求在香港聯交所[編纂]，以持續推進公司國際化戰略及全球化佈局，搭建國際化資本運作平台，增強境外融資能力，進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力。有關詳情，請參閱本文件「業務 — 增長戰略」及「未來計劃及[編纂]」。

近期發展及無重大不利變動

自2026年初以來，我們著力擴大產能、加大生產投入並提升自動化水平，以實現產能與效率的雙重提升。這一時期，我們的銷量保持穩步增長。同時，我們持續推進激光器芯片研發。

2026年3月23日，本公司董事會審議通過了一項利潤分配及資本公積轉增股本方案（「**2025年利潤分配方案**」）。根據2025年利潤分配方案，本公司將：(i)每10股現有A股派發現金紅利人民幣7.0元（含稅）；及(ii)每10股現有A股以資本公積金轉增4.5股新A股。本公司目前作為庫存股持有的275,169股A股將不參與2025年利潤分配方案。2025年利潤分配方案尚需提交預計於2026年上半年舉行的年度股東大會審議批准。假設本公司股本概無其他變動，於轉增方案完成後，我們的已發行總股本（包括作為庫存股持有的A股）將由85,947,726股A股增加至124,500,377股A股。

董事確認，自2025年12月31日（即本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表的最新資產負債表日期）起直至本文件日期，我們的財務或貿易狀況或前景並無發生重大不利變動。